# JP7005693

Publication Title:

METHOD AND EQUIPMENT FOR PROVIDING PATTERNIZED RELIEF OF HARDENED PHOTORESIST ON FLAT SUBSTRATE SURFACE

Abstract:

Abstract of JP7005693

PURPOSE: To provide a method suitably used for seamlessly reproducing a relief pattern 10&times 10&mu m in size on a surface 1&times 1m in size. CONSTITUTION: In a device for reproducing a patterned synthetic resin relief 37 on a surface 25 of a glass substrate 27, the substrate surface 25 is coated with an acrylate lacquer 33 that can be hardened by ultraviolet rays, and then a transparent mold 3 having relief 13 is rolled on the surface 25. The lacquer is hardened at a place of a focal line 23 by an ultraviolet ray source 17 and an elliptical mirror to form relief 37. The relief 13 of the mold 3 is reproduced on the glass substrate 27. By this method, small-sized relief (10&times 10&mu m) is formed seamlessly on a large flat surface (1&times 1m) without hindrance due to large peeling force.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

\_\_\_\_\_

Courtesy of http://v3.espacenet.com

# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

# (11)特許出願公開番号

# 特開平7-5693

(43)公開日 平成7年(1995)1月10日

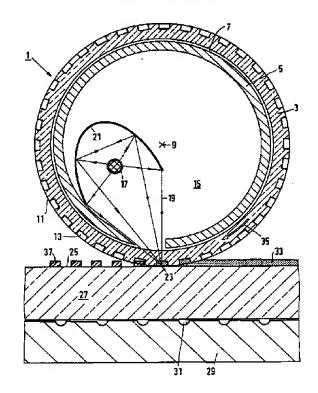
(51) Int.Cl. <sup>6</sup> G 0 3 F 7/20 G 0 2 B 5/20 G 0 9 F 3/02 H 0 1 L 21/027	識別記号 5 0 1 1 0 1 F	庁内整理番号 9122-2H 8507-2K 7323-5G	FΙ	技術表示箇所
		7352-4M		21/30502Z未請求 請求項の数10OL (全 6 頁)
(21)出願番号	特願平6-45855		(71)出願人	
(22)出願日	平成6年(1994)3月	月16日		フィリップス エレクトロニクス ネムロ ーゼ フェンノートシャップ PHILIPS ELECTRONICS
(31)優先権主張番号	93200758:	: 6		NEAMLOZE VENNOOTSH
(32)優先日	1993年3月16日			AP
(33)優先権主張国	オランダ(NL)			オランダ国 5621 ベーアー アインドー
				フェン フルーネヴァウツウェッハ1
			(72)発明者	ヤン ハイスマ
				オランダ国 5621 ベーアー アインドー
				フェン フルーネヴァウツウェッハ 1
			(74)代理人	弁理士 杉村 暁秀 (外5名)
				最終頁に続く

# (54) 【発明の名称】 平坦な基板表面に硬化フォトレジストのパターン化レリーフを設ける方法および装置

# (57)【要約】

【目的】  $1 \times 1$  mの表面に $10 \times 10 \mu$  mのレリーフ パターンをシームレスに複製するに好適に用いられる方 法を提供せんとするものである。

【構成】 ガラス基板27の表面25にパターン化合成 樹脂レリーフ37を複製する装置において、基板表面2 5に紫外光で硬化し得るアクリレートラッカー33を被 着し、その後レリーフ13を有する透明モールド3を表 面25上でロールする。紫外線源17および楕円形ミラ -37によってラッカーを焦線23の箇所で硬化してレ リーフ37を形成する。モールド3のレリーフ13をガ ラス基板27上に複製する。上述した方法によって大き な剥離力による障害なく小寸法 (10×10μm) のレ リーフを大きなフラット表面(1×1m)上にシームレ スに設けることができる。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 平坦な基板表面に硬化フォトレジストの パターン化レリーフを設けるに当たり、基板表面に紫外 光で硬化し得る液状フォトレジストの層を設け、その後 フォトレジストに設けるべきパターン化レリーフと相補 の関係にあるレリーフを有し、紫外光源からの紫外光に 曝されてほぼ硬化する紫外光透過モールドと接触せしめ てパターン化レリーフを形成し、その後硬化レリーフの モールドを除去するようにした平坦な基板表面に硬化フ ォトレジストのパターン化レリーフを設ける方法におい 10 て、前記モールドとして円筒軸を中心として回転する中 空円筒モールドを用い、その円筒表面の外側に前記レリ 一フを設けるとともに前記円筒軸を前記基板表面に平行 に延在させ、前記モールドの内部に第1焦線および第2 焦線を有する楕円ミラーを設け、これら焦線を前記基板 表面に平行に延在させ、第1焦線は前記紫外光源の長手 軸線に一致させ、第2焦線を基板表面に対するモールド の接線に一致させて、前記基板表面を前記回転モールド に非スリップ状態で接触させながら、前記フォトレジス トを第2 焦線の箇所で硬化させて前記パターン化レリー 20 フの一部分を形成するようにしたことを特徴とする平坦 な基板表面に硬化フォトレジストのパターン化レリーフ を設ける方法。

【請求項2】 前記モールドは最大で10-6/℃の線熱 膨張係数を有する材料から形成することを特徴とする請 求項1に記載の平坦な基板表面に硬化フォトレジストの パターン化レリーフを設ける方法。

【請求項3】 前記モールドの材料は熔融シリカ、ガラ スセラミックまたは膨張係数の小さなガラスから形成す るようにしたことを特徴とする請求項2に記載の平坦な 30 基板表面に硬化フォトレジストのパターン化レリーフを 設ける方法。

【請求項4】 前記モールドは完全に1回店させるよう にしたことを特徴とする請求項1~3の何れかの項に記 載の平坦な基板表面に硬化フォトレジストのパターン化 レリーフを設ける方法。

【請求項5】 前記モールドには剥離財を設けるように したことを特徴とする請求項1~4の何れかの項に記載 の平坦な基板表面に硬化フォトレジストのパターン化レ リーフを設ける方法。

【請求項6】 前記基板にはフォトレジストに対する接 着性モノマーを設けるようにしたことを特徴とする請求 項1~5の何れかの項に記載の平坦な基板表面に硬化フ ォトレジストのパターン化レリーフを設ける方法。

【請求項7】 液晶表示装置の受動プレートを基板とし て用いるようにしたことを特徴とする請求項1~6の何 れかの項に記載の平坦な基板表面に硬化フォトレジスト のパターン化レリーフを設ける方法。

中空円筒と、円筒軸を中心として回転し 【請求項8】

けるべきパターン化レリーフと相補の関係にあるレリー フを設け、前記モールドの内側には少なくとも1つの紫 外光源と前記円筒軸に平行に延在し且つ前記レリーフに 一致するラインに前記紫外光を収束する手段とを設け、 他に前記基板を固着する手段を有し、且つ少なくとも露 光中前記基板表面および回転自在のモールドを近接して 接触させて基板表面およびモールドが互いにロールオフ し得るようにした基板キャリアを具えることを特徴とす る基板の平坦表面に硬化フォトレジストのパターン化レ リーフを設ける装置。

【請求項9】 前記紫外光を収束する手段を楕円ミラー としたことを特徴とする請求項8に記載の基板の平坦表 面に硬化フォトレジストのパターン化レリーフを設ける 装置。

【請求項10】 前記基板を固着する手段は前記基板キ ャリアのチャネル状孔で構成し、この孔を真空ポンプに 連通させるようにしたことを特徴とする請求項8に記載 の基板の平坦表面に硬化フォトレジストのパターン化レ リーフを設ける装置。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は平坦な基板表面に硬化フ ォトレジストのパターン化レリーフを設けるに当たり、 基板表面に紫外光で硬化し得る液状フォトレジストの層 を設け、その後フォトレジストに設けるべきパターン化 レリーフと相補の関係にあるレリーフを有し、紫外光源 からの紫外光に曝されてほぼ硬化する紫外光透過モール ドと接触せしめてパターン化レリーフを形成し、その後 硬化レリーフのモールドを除去するようにした平坦な基 板表面に硬化フォトレジストのパターン化レリーフを設 ける方法に関するものである。 また、本発明はかかる 方法を実施する装置に関するものである。

# [0002]

【従来の技術】この種の方法は例えばパターン化レリー フがカラーフィルタ間のいわゆるブラックマトリックス より成る液晶表示装置(LCDおよびLC-TV)の平 坦なスクリーンの製造に用いられる。さらにこの方法は フラット陰極線管および電子ファイバ表示装置のような フラットカラー表示管のスクリーンにパターン化レリー フを製造する際にも用いることができる。また、かかる 方法は反射を低減(アンチグレア)するために粗さが規 定されたフラットTVスクリーンを形成するために用い ることもできる。

【0003】この種方法は特願平3-54569号明細 書の抄録から既知である。この既知の方法ではフォトレ ジストの液滴を平坦な基板および平坦なモールド間に設 け、このモールドには凸部の形状に設けるべきレリーフ と相補の関係にある凹部の形状のパターン化レリーフを 設ける。次いでモールドおよび基板を互いに押圧してフ 得る紫外光透過モールドとを具え、円筒表面の外側に設 50 ォトレジストを基板表面全体に広げるようにする。次

*4*∩

に、フォトレジストを基板またはモールドを経て紫外光 に露出して硬化させる。フォトレジストが硬化した後モ ールドを基板から取外し基板の硬化フォトレジストにモ ールドのレリーフの相補パターンを残存させる。文献に よれば、既知の方法をレプリカと称す。この際、形成さ れたレリーフの凸部の寸法は例えば10×10μmであ る。また硬化したフォトレジストは硬化レリーフの凸部 間にも存在するため、このフォトレジストは均一なエッ チング処理によって除去する必要がある。

# [0004]

【発明が解決しようとする課題】かかる既知の方法には 幾多の欠点がある。即ち、既知の方法において例えば1 ×1mの大きな表面にレリーフパターンを形成するのは 好適ではない。即ち、最大で30×30cmの寸法に制 限される。寸法が大きくなれば、大きな接着力が作用す るため、硬化フォトレジストからモールドを取外すのに 問題がある。剥離財を用いるとしても大面積の剥離には 充分な力を必要とするため、基板および/またはモール ドが損傷するようになる。しかし、可撓性のある基板お よび/またはモールドは一層容易に剥離し得るが、この 20 可撓性のある基板および/またはモールドは例えば再現 性のある精度を得るのが不可能であるか又は不所望であ る。レリーフを有する大きな表面を得るためには、原理 的にはこのレリーフを多数の併置されたレプリカ表面で 構成することができる。しかし、この方法にはレプリカ 表面を正確に併置して連続レプリカの不適合により生ず る可視シームが形成されるのを防止する必要のある欠点 がある。既知の方法の他の欠点はモールドおよび基板を 積み重ねて配列する際に液状フォトレジストに気泡が含 き表面の寸法とともに増大する。既知の方法のさらに他 の欠点はレリーフの凸部間に存在するフォトレジストを 除去するために、硬化フォトレジストに施される上述し たエッチング処理を必要とすることである。

【0005】本発明の目的は特に上述した欠点を有さ ず、しかも、例えば $1 \times 1$ mの表面に $10 \times 10 \mu$ mの レリーフパターンをシームレスに複製するに好適に用い られる方法を提供せんとするにある。 また本発明の目 的はかかる方法を実施する装置を提供せんとするにあ る。

### [0006]

【課題を解決するための手段】本発明は平坦な基板表面 に硬化フォトレジストのパターン化レリーフを設けるに 当たり、基板表面に紫外光で硬化し得る液状フォトレジ ストの層を設け、その後フォトレジストに設けるべきパ ターン化レリーフと相補の関係にあるレリーフを有し、 紫外光源からの紫外光に曝されてほぼ硬化する紫外光透 過モールドと接触せしめてパターン化レリーフを形成 し、その後硬化レリーフのモールドを除去するようにし た平坦な基板表面に硬化フォトレジストのパターン化レ 50 は1×1mとし、モールドを基板に沿ってロールさせる

リーフを設ける方法において、前記モールドとして円筒 軸を中心として回転する中空円筒モールドを用い、その 円筒表面の外側に前記レリーフを設けるとともに前記円 筒軸を前記基板表面に平行に延在させ、前記モールドの 内部に第1焦線および第2焦線を有する楕円ミラーを設 け、これら焦線を前記基板表面に平行に延在させ、第1 焦線は前記紫外光源の長手軸線に一致させ、第2焦線を 基板表面に対するモールドの接線に一致させて、前記基 板表面を前記回転モールドに非スリップ状態で接触させ 10 ながら、前記フォトレジストを第2焦線の箇所で硬化さ せて前記パターン化レリーフの一部分を形成するように したことを特徴とする。

#### [0007]

【作用】本発明によれば紫外光透過モールドを円形垂直 断面を有する中空円筒によって形成する。円筒表面の外 側には基板に設けるべきレリーフに相補形状に対応する パターン化レリーフを設ける。このレリーフは円筒表面 に凹部または凸部として形成する。この円筒状モールド は基板表面に載置して円筒軸が表面に平行に延在し得る ようにする。この円筒状モールドは基板表面に沿ってス リップしないようにロールする。このロール操作は円筒 状モールドを駆動することにより、または基板を直線状 に移動させることによって達成でき、従って円筒状モー ルドは基板表面に摩擦接触して回転する。この基板には 紫外光に露出されて硬化し得る特性を有する液状フォト レジストの層を設ける。円筒状モールドの内部には円筒 軸に平行に延在する2つの焦線を有する楕円ミラーを設 ける。一方の焦線の位置には細長紫外光源を位置させ、 その紫外光をミラーによって第2焦線に収束させる。こ まれるようになる危険性がある。この危険性は複製すべ 30 の第2 焦線は基板表面に対する円筒状モールドの接線に 一致させるようにする。基板表面に沿うモールドの回転 中、接線は基板表面に沿って円筒軸に平行な方向に移動 する。基板表面に沿うモールドの回転中、紫外光源およ び楕円ミラーは移動接線に対し固定されたままである。 紫外光が収束露光されるため、フォトレジストは接線の 箇所で硬化する。硬化されたフォトレジストは基板表面 に接着するとともに回転モールドから剥離されるように なる。本発明による剥離は極めて狭い表面区域に沿って のみ生じるため、必要な剥離力は平坦なモールドの場合 におけるよりも著しく小さくなる。モールドおよび基板 間の接触表面を極めて狭くすることにより液状フォトレ ジスト内に気泡が含まれる危険性とモールドおよびラッ カー間に空気が含まれる危険性とを最小にする。その理 由はモールドおよび基板を互いに押圧する間に液状フォ トレジスト内に気泡が圧入されることはないからであ る。モールドの回転中にパターンを平坦な基板に転写す る。典型的な例ではレリーフは寸法が $10 \times 10 \mu m$ で 厚さが2μmの硬化フォトレジストのブロックの行より 成り、ブロック間の距離は10μmとする。基板の寸法

40

場合には円筒状モールドはその理由はの長さをほぼ1m とし、外径をほぼ0. 3mとする。このモールドによれ ば、極めて小さな寸法 (10×10μm) のレリーフを 有する大きな寸法 (1×1m) のシームレスに複製した 表面を得ることができる。

【0008】フォトレジストとしては、エポキシおよび アクリレートを主成分とするフォトレジストのような多 くの既知の紫外光で硬化し得るフォトレジストを用いる ことができる。極めて好適なフォトレジストは共働して クロスリンクされ従って硬質ポリマーネットワークを形 *10* 成するジアクリレートおよびトリアクリレートである。 アクリレートは紫外光に曝されると室温で急速に硬化す る。アクリレートの例としては1,6-ヘキサネジオー ル ジアクリレート、トリプロピレングリコール ジア クリレート、ビス (2-ハイドロキシエチル) ビスフェ **ノール-A-ジメタアクリレートおよびトリメチルオル** プロパン トリアクリレートがある。またフォトレジス トは∞, ∞-ジメトキシ-∞-フェニールアセトフェノ ンのような好適な光開始剤の数重量%を具える。

【0009】フォトレジストを露光するためには使用す 20 る光開始剤に依存し例えばほぼ360nmの波長範囲で 紫外光を放射する1つ以上の紫外線蛍光灯また高圧水銀 蒸気ランプを用いる。

【0010】透明な円筒状モールドの材料はガラスまた はPMMAのような合成樹脂とすることができる。しか し、高精度および満足な再現性を達成するためにはモー ルドは線熱膨張係数(TEC)の低い材料から製造する のが好適である。作動時にはモールドの温度は紫外光源 により数度上昇する。代表的な例では、必要な寸法精度 は $1:10^{5}$  (即ち、1m毎に $10\mu$ ) である。この精 30 度を保持するためにはモールドの材料のTECを最大で 10-6/℃とする。モールドに対する好適な材料は例え ば510-7/℃のTECを有する熔融シリカである。こ の材料は数社、例えば商標名Homosil1ッでSch ott 社から販売されている。

【0011】モールドに対する他の好適な材料は例えば Schott社の商標名Zerodur™およびCor ning社の商標名ULE™(ウルトラーロウエキスパ ンジョンガラス) のようなガラスセラミックである。こ れらの両材料は $5 \times 10-8$ / $\mathbb{C}$ の極めて低いTECを有 40 体を設けるために用いることもできる。 し、近-紫外光(A>300nm)に透過である。

【0012】本発明方法の特定の例ではモールドを36 0℃で回転させるようにする。これは円筒状モールドの 周面に相補形状の設けるべき完全なレリーフを具える。 かかるモールドによって基板に設けるべき硬化フォトレ ジストのシームレスパターンを得ることができる。

【0013】モールドには剥離剤を設けて硬化フォトレ ジストを複製処理中に一層容易にモールドから剥離し得 るようにするのが好適である。剥離剤としては次に示す チルシリルジエチールアミンおよびトリメチルメトキシ シランのような既知の剥離剤を用いることができる。こ れらのシランはモールドの表面のSi-OH基と反応し てモールド表面に共有結合された-SiO-Si (CH 。)。を形成する反応基を具える。これら反応基によっ てモールドの表面をフォトレジストから遮蔽する。或は 又メチルシランの代わりに他のアルキルシランを用いる ことができる。モールドの表面は気相または液相から慣

例のようにシラン化することができる。剥離剤としてオ クタデシル酸のような高級脂肪酸を用いることもでき る。

【0014】一般にガラス表面である基板表面にはフォ トレジストの接着促進剤を設けるのが好適である。フォ トレジストの接着促進剤としてはシランのような既知の 多くの接着促進剤を用いることができる。フォトレジス トとしてアクリレートを用いる場合には、シランはアク リレート基およびアルコキシ基およびハロゲン原子のよ うなガラス表面の-Si-OH基と反応する基を具え る。フォトレジストは-Si-O-Si-結合を経てガ ラス表面に共有結合する。アクリレート含有フォトレジ ストに対しシランを好適に結合する例は3- (メタクリ ルオキシ)プロピルトリメトキシシランおよび3-(メ タクリルオキシ) プロピルトリクロロシランである。フ ォトレジストがエポキシまたはポリエステルを具える場 合にはエポキシ基を有するシランを用いる。

【0015】本発明方法は液晶表示装置(LCDおよび LC-TV) の能動プレートにパターン化レリーフを設 けるのに極めて好適である。かかるLC装置では能動プ レートはパラメータに従って設けられた赤、緑および青 のカラーフィルタを具える。カラーフィルタ間のコント ラストを改善するためには吸光格子、いわゆる"ブラッ クマトリックス"をカラーフィルタ間にしばしば設け る。この格子はしばしばクロミウムまたはニッケルのよ うなブラック染料または金属で構成する。本発明方法に よれば吸光格子は、例えばブラック染料または金属フィ ルムの薄層のパターンに従ってフォトレジストを設け、 その後エッチングにより染料または金属層の被覆しなか った部分を除去することにより得ることができる。

【0016】本発明方法はカラーフィルタのパターン自

【0017】さらに、本発明方法はフラット陰極線管お よび電子ファイバ表示装置のようなフラットカラー表示 装置のスクリーンにパターン化レリーフを製造する際に 用いることができる。また、この方法は反射を低減する ために(アンチグレア)、粗さが規定されたフラットT Vスクリーンを設けるためにも用いることができる。

【0018】また、本発明による基板の平坦表面に硬化 フォトレジストのパターン化レリーフを設ける装置は中 空円筒と、円筒軸を中心として回転し得る紫外光透過モ 種類のシラン、即ち、トリメチルクロロシラン、トリメ 50 ールドとを具え、円筒表面の外側に設けるべきパターン

7

化レリーフと相補の関係にあるレリーフを設け、前記モ ールドの内側には少なくとも1つの紫外光源と前記円筒 軸に平行に延在し且つ前記レリーフに一致するラインに 前記紫外光を収束する手段とを設け、他に前記基板を固 着する手段を有し、且つ少なくとも露光中前記基板表面 および回転自在のモールドを近接して接触させて基板表 面およびモールドが互いにロールオフし得るようにした 基板キャリアを具えることを特徴とする。

【0019】本発明装置の好適な例では、前記紫外光を 収束する手段を楕円ミラーとする。上述したように紫外 10 光源は楕円状ミラーの一方の焦線に設けるが、他方の焦 線は基板に対する円筒状モールドの周面のレリーフの接 線に一致させるようにする。両焦接線は円筒軸に平行に 延在させるようにする。

【0020】また、前記基板を固着する手段は前記基板 キャリアのチャネル状孔で構成し、この孔を真空ポンプ に連通させるようにするのが好適である。複製処理中基 板は基板キャリアに動き得ないように固着したままとす る。基板は基板キャリアを介して円筒状モールドに対し 機械的に、または空気力学的に押圧して基板およびモー ルドがそれぞれに対しスリップしないようにロール移動 せしめるようにする。

【0021】複製処理中円筒状モールドは紫外光源およ び楕円状ミラーの周囲を回転し、且つ例えば既知の高チ ルト剛性を有する空気ベアリングから懸垂する。

【0022】かかる装置によっても平坦なマザーモール ドを基にして円筒状モールドを製造するこができる。所 望のパターン化レリーフを写真食刻で設けたフラットガ ラスプレートを基板キャリアに配列する。このレリーフ には剥離剤を設ける。このガラスプレートはマザーモー 30 ルドとして用い、且つこれに紫外光で硬化するフォトレ ジストの層を設ける。マザーモールドのこのレリーフを 紫外光透過中空円筒の周面には順次転写する。初期状態 では円筒の周面は平滑であり、且つこれにフォトレジス ト用の接着層を設ける。このフォトレジストは中空円筒 の楕円状ミラーを介して紫外光源に露出され、マザーモ ールドに対する円筒の接線の位置で硬化する。円筒を回 転することにより硬化フォトレジストをマザーモールド から剥離して円筒の周面に接着する。円筒が1回転する とマザーモールドの相補レリーフは円筒に転写される。 硬化フォトレジストのレリーフを有する円筒は例えば弗 素含有プラズマ内で例えば反応性イオンエッチング(R IE) によりエッチングして硬化フォトレジストを除去 し円筒の材料に凹状レリーフを形成する。またこのレリ ーフはレーザ食刻により円筒に設けることもできる。円 筒、フォトレジスト、接着促進剤および剥離層に用いら れる材料は上述した所と同様である。かくして製造した 周面にレリーフを有する円筒を本発明方法および装置の モールドとして用いる。

[0023]

8

【実施例】図において、符号1は本発明方法を実施する 装置の断面を示す。本発明装置の主構成素子はCorn ing社から市販されているULE™(超低膨張ガラ ス) の円筒状モールド3を具える。この材料は5×10 -8/℃の極めて低いTECおよび近紫外光に対する透過 性を有する。円筒状モールド3の長さは1mとし、外径 を31cmとする。円筒状モールド3は高チルト剛性を 有する軸 (図示せず) を中心として回転自在とするとと もに金属製の空気ベアリング5から懸垂する。モールド 3とベアリング5との間には増大空気圧で充填された空 隙7を設ける。この軸は幾何学的軸9を中心として回転 自在とする。円筒状モールド3の外周面11には寸法が  $10 \times 10 \mu m$ および深さが  $2 \mu m$ の正方形の凹部の併 置行より成るパターン化レリーフの凹部13を設ける。 このレリーフにはトリメチルクロロシランの剥離剤(図 示せず)を設ける。円筒状モールド3の内部15には楕 円形ミラー21の第1焦線に配列された細長紫外線蛍光 ランプ17を設ける。紫外光源から放出されたほぼ35 0 nmの波長を有する紫外光19をミラー21によりミ ラーの第2焦線23に収束する。両焦線は円筒状モール ド3の軸9に平行とする。第2焦線23は円筒状モール ド3の外周面11に一致させる。この第2焦線23はミ ラー21により適宜位置決めしてこれが外周面11に対 する接線およびガラス基板27の表面25に一致し得る ようにする。基板27はその寸法を1×1mとし、厚さ を5 μmとする。基板27の表面25には接着促進剤と して3-(メタクリロキシ)プロピルトリメトキシシラ ン (VentronによるA174) の層 (図示せず) を設ける。この基板27をスチール製の基板キャリア2 9上に配列し、且つ基板キャリア29のチャネル (図示 せず)の出口31の箇所で下圧によりこれに固着する。 これらチャネルは真空ポンプ(図示せず)に連通する。 基板27は基板キャリア29を介してモールド3に対し て押圧しモールド3が基板表面25上をスリップしない で回転し得るようにする。ガラス基板27の表面25に は紫外光で硬化し得る液状フォトレジストの層33を被 着する。フォトレジストとしてはAkuzo Chem ine社製のダクリル (Dacry1) 101™ (ビス フェノール A ジーメタクリレート)を用いこれに3 重量%の光開始剤 (Chba Geigy社製のIrg acure 6571M)を添加する。このフォトレジス トは紫外光の露出により接線23の箇所で硬化する。基 板表面25の硬化フォトレジストの凹部37はモールド 3を矢印35の方向に回転移動させることにより形成す る。凹部37はモールド3のレリーフ13の相補を成す ものである。モールド3が完全に1回転した後モールド 3のパターン化レリーフ13は硬化フォトレジスト37 のレリーフの形状で基板表面25上に転写される。モー ルド3および基板27間の接触表面が極めて狭いため、

50 複製処理中に必要な剥離力はフラットモールドの場合よ

りも著しく小さくなる。従ってパターン化レリーフ37 はフラット基板表面25上に極めて正確に設けられるよ うになる。

# [0024]

【発明の効果】本発明方法によれば小寸法(10×10 μm)のパターン化レリーフを大表面に極めて正確に設 けることができ、且つ必要な剥離力を極めて小さくする ことができる。

# 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明平坦な基板表面に硬化フォトレジストの 10 25 基板表面 パターン化レリーフを設ける方法を実施する装置の例を 示す断面図である。

# 【符号の説明】

- 1 平坦基板表面に硬化フォトレジストのパターン化レ
- リーフを設ける装置
- 3 円筒状モールド
- 5 ベアリング

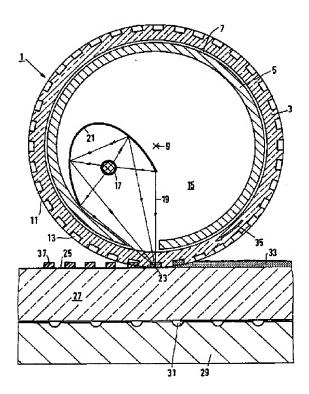
7 空隙

- 9 軸
- 11 外周面
- 13 パターン化レリーフ凹部

10

- 15 モールド内部
- 17 紫外線蛍光ランプ
- 19 紫外光
- 21 楕円形ミラー
- 23 焦線
- 27 基板
- 29 基板キャリア
- 31 出口
- 33 フォトレジスト層
- 35 矢印
- 37 パターン化レリーフ凹部

【図1】



フロントページの続き

- (72)発明者 マルチヌス ヨハネス フェルヘーイエン オランダ国 5621 ベーアー アインドー フェン フルーネヴァウツウェッハ 1
- (72)発明者 ヨハネス トーマス スヒラマ オランダ国 5621 ベーアー アインドー フェン フルーネヴァウツウェッハ 1